

证券代码：603306
债券代码：113677

证券简称：华懋科技
债券简称：华懋转债

公告编号：2024-113

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2024 年第九次临时董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第九次临时董事会会议于 2024 年 12 月 19 日在厦门市集美区后溪镇苏山路 69 号公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由蒋卫军先生召集和主持。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人（其中通讯表决方式出席会议 9 人），公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于增加 2024 年第二次以集中竞价方式回购股份规模的议案》

同意公司增加 2024 年第二次以集中竞价方式回购公司股份方案的回购股份规模，由“不低于人民币 2.50 亿元（含），不超过人民币 5.00 亿元（含）”增加为“不低于人民币 4.00 亿元（含），不超过 8.00 亿元（含）”。除调整回购规模外，本次回购方案的其他内容未发生变化。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，议案通过。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华懋科技关于增加 2024 年第二次以集中竞价方式回购股份规模的公告》。

特此公告。

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 12 月 20 日